

信頼性試験結果

Reliability Test

XBSC11シリーズ

XBSC11 Series

パッケージ

: TO-220AC

RoHS対応品 / RoHS Compliance

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	175°C VR=850V	2000	0/22
2	順方向電流 Forward Current	IF=10A (Ta=-55°C)	2000	0/22
3	高温保存 High Temperature Storage	175°C	2000	0/22
4	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VR=100V	1000	0/22
5	温度サイクル Temperature Cycle	-55°C～150°C 各30分 30min each	100CYC.	0/22
6	プレッシャークーカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10 ⁵ Pa VR=42V	100	0/22
7	プレッシャークーカー UFAST	130°C85%RH 2×10 ⁵ Pa	100	0/22
8	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C/85%RH168h→260°C10Sリード浸漬 THB,HAST,UFAST,TCの前処理 85°C/85%RH168h→260°C10S lead dipped, pre-treatment of THB,HAST,UFAST,TC Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020	-	0/11
9	静電耐圧 Electric Static Discharge	HBM R=1500Ω C=100pF ±2kV	3回 3 times	0/5
		CDM ±1kV	3回 3 times	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	端子引っ張り Terminal Strength	1N 10秒 1N 10s	0/5
2	はんだ付け性 Solderability	105°C/100%RH/4h→245°C5Sリード浸漬 105°C/100%RH/4h→245°C5S lead dipped	0/11